

RUPALIT® Profil

RUPALIT® Plus Profil

Produktdatenblatt

PACK
LitzWire

family owned
since 1933

RUPALIT® Profil HF-Litzen nutzen den Wickelraum Ihres Bauteils optimal. Erhöhung des Kupferfüllfaktors bei gleichem Bauteilvolumen



Besonderes bei großen Litzen-Querschnitten ergeben sich signifikante Verbesserungen des Kupferfüllfaktors

Vorteile

- Verbesserter Kupferfüllfaktor
- Reduzierung der Anzahl der Lagen
- körperlose Wicklung mit Backlack/Acetatside
- Auch als RUPALIT® Safety erhältlich
- Rechteck oder Quadrat

Technische Daten

Aufbau

- Kupferlackdrähte (0,02–0,80 mm, 20–52 AWG)
- Leiterquerschnitte nach DIN oder nach Kundenwunsch

Isolationsmaterial

als elektrischer und mechanischer Schutz

Garn

- Naturseide (52) – Naturgarn für Anwendungen mit maximaler Flexibilität und hoher Güte
- Polyamid (63, PA6.6, Nylon®) – robustes Textilgarn mit hoher mechanischer Beständigkeit
- Weitere Materialien auf Anfrage: Glasseide, Kunstseide

Folie

- PET (Polyethylenterephthalat, Polyester, Mylar®) – Folie als klassisches Isolationsmaterial mit ausgezeichneter dielektrischer Festigkeit
- PEN (Polyethylenaphthalat, Teonex®) – Folie für Hochtemperaturanwendungen
- PI (Polyimid, Kapton®) – Folie für extreme thermische Anforderungen
- Weitere Materialien auf Anfrage



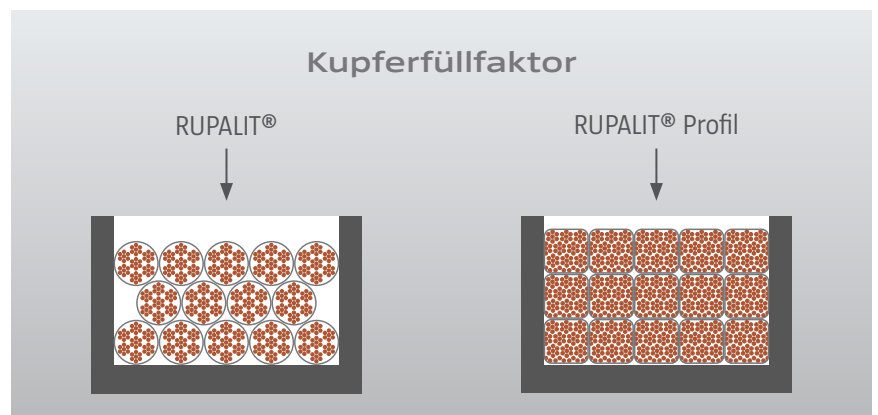
RUPALIT® Plus Profil

Anwendungen

- HF-Transformatoren
- HF-Übertrager
- Elektronische
- Vorschaltgeräte



RUPALIT® Profil



Nylon®, Mylar®, Teonex® und Kapton® sind eingetragene Markenzeichen der Firmen DuPont, Mylar Specialty Films